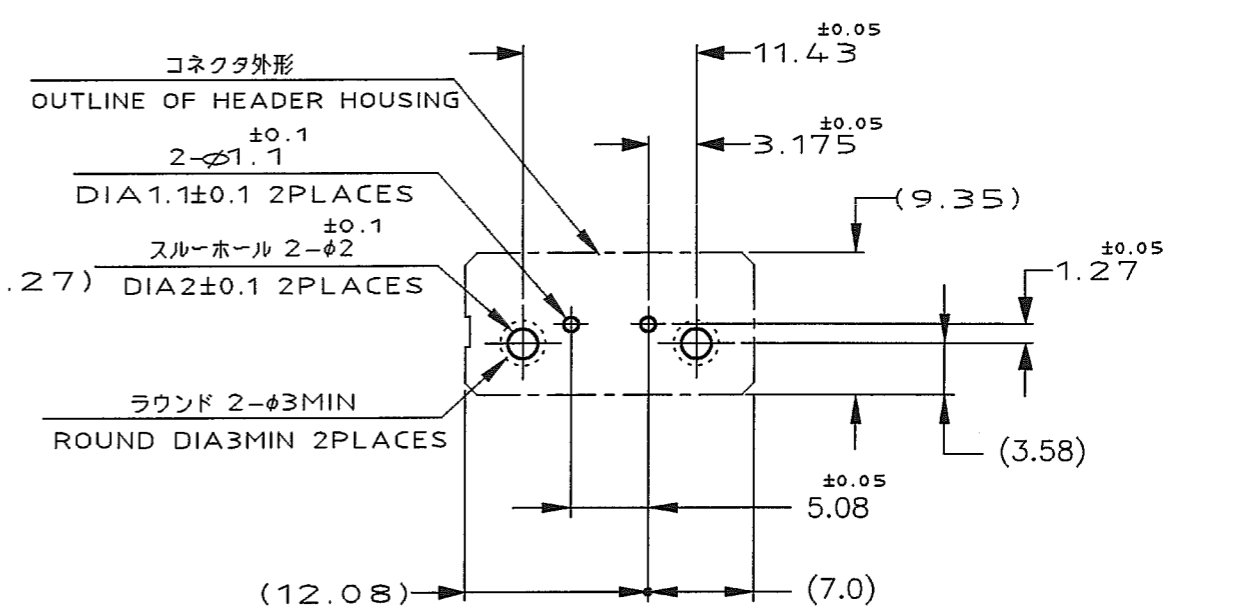
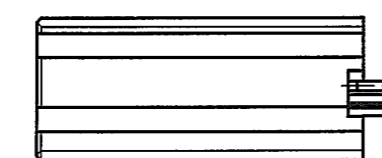
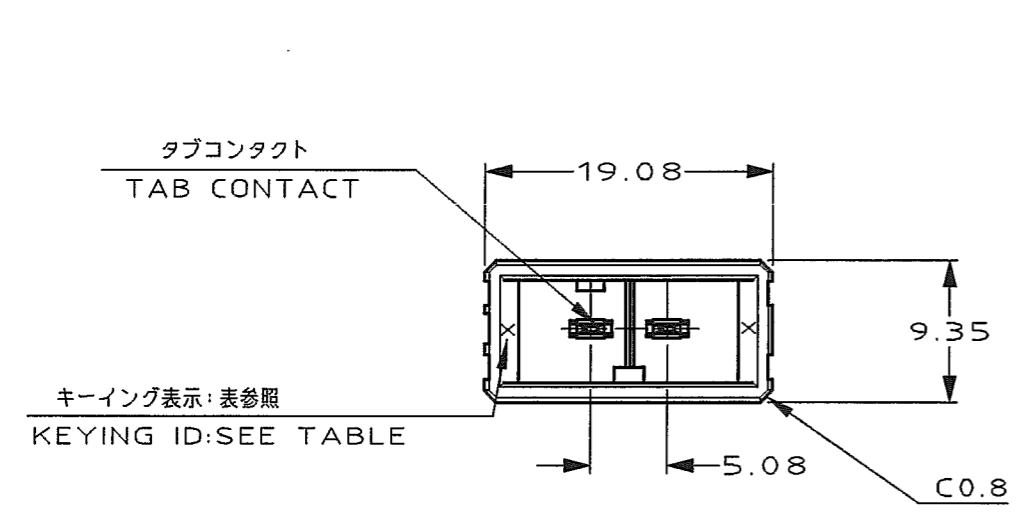
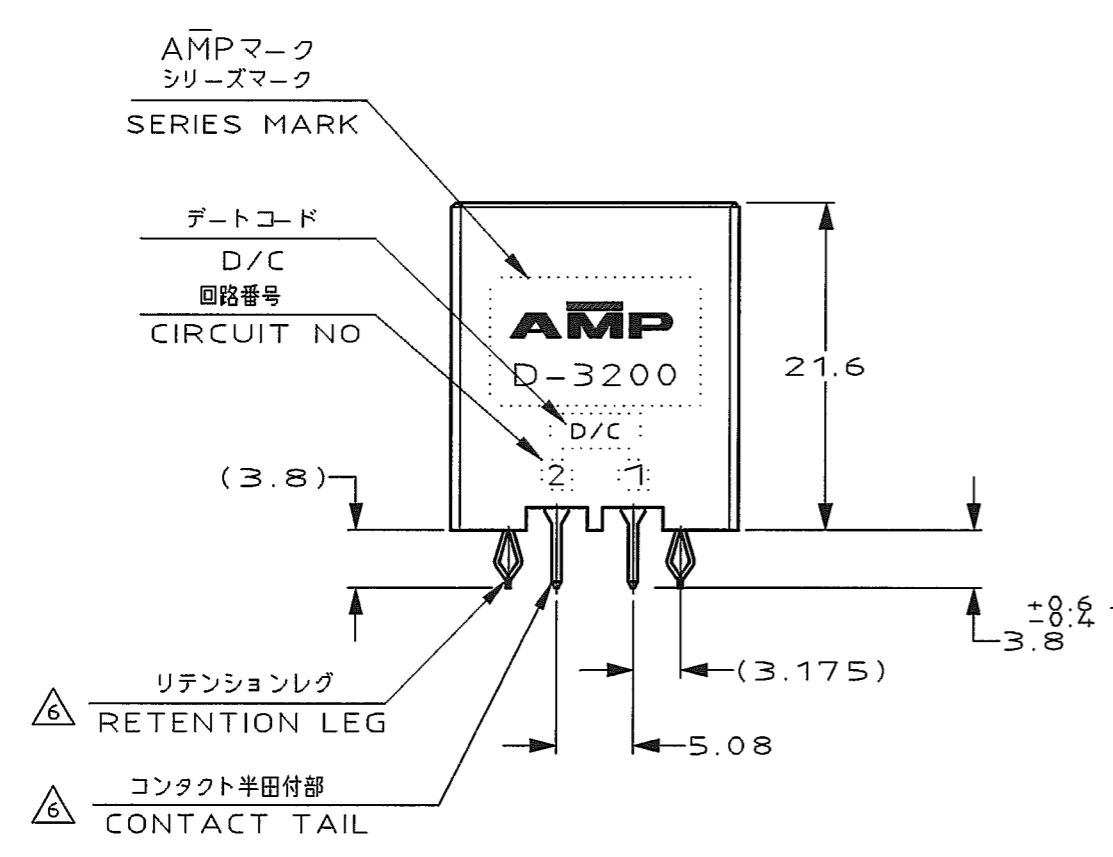


NUMBER 917337
 METRIC
 3rd ANGLE PROJECTION



推奨基板取付け寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
 コネクタ: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
 ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
 ニッケル下地の上にスズめっき

	Y			2-917337-5
	X			2-917337-3
	X			2-917337-2
	Y			1-917337-5
	X			1-917337-3
	X			1-917337-2

Copyright © 1994 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm(AWG)		mm		ダイナミック D-3200S 5.08ピッチ(V) 2極 ヘッダーアセンブリー	
MATERIAL		FINISH		DYNAMIC D-3200S 5.08PITCH(V) 2 POS.HDR CONN.ASS'Y	
SEE NOTES		SEE NOTES		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
注記参照		注記参照		SIZE LOC NUMBER	
DR. 18/OCT/94		DE. 18/OCT/94		A3 J C-917337	
K.IKEDA		K.IKEDA		SCALE	
19 OCT 94		19 OCT 94		2-1	
CHK. S.MANABE		APP. S.MANABE		REV. B	
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE		SHEET 1 OF 1	

PRINT DIST DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT